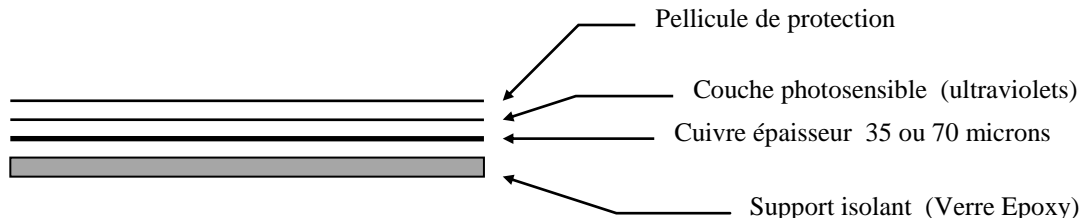
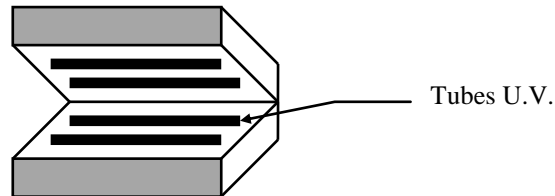


Circuits imprimés.

Constitution d'une plaque simple face :



Insoleuse :



Attention : Orcad trace les pistes vues côté composants.

⇒ Positionner le calque côté encre en contact avec le cuivre (pour un circuit simple face).

La partie opaque du calque (pistes) protège la couche photosensible des U.V.

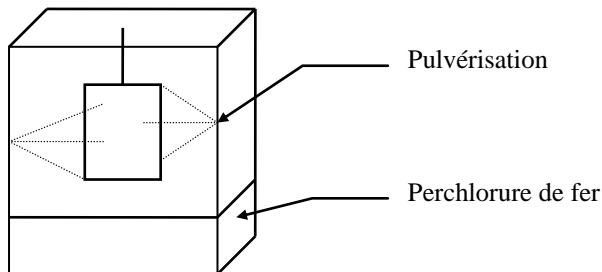
Contrôler que le vide est bien effectué.

Temps d'insolation : 4mn (240s).

⇒ Révélateur (Soude) qui détruit la couche photosensible insolée.

⇒ Rinçage.

Machine à graver :



Le Perchlorure de fer élimine le cuivre non protégé par la couche photosensible.

⇒ Rinçage.

⇒ Elimination de la couche photosensible restante (Alcool à brûler).

⇒ Perçage.

⇒ Implantation des composants.

⇒ Soudage (Etain).